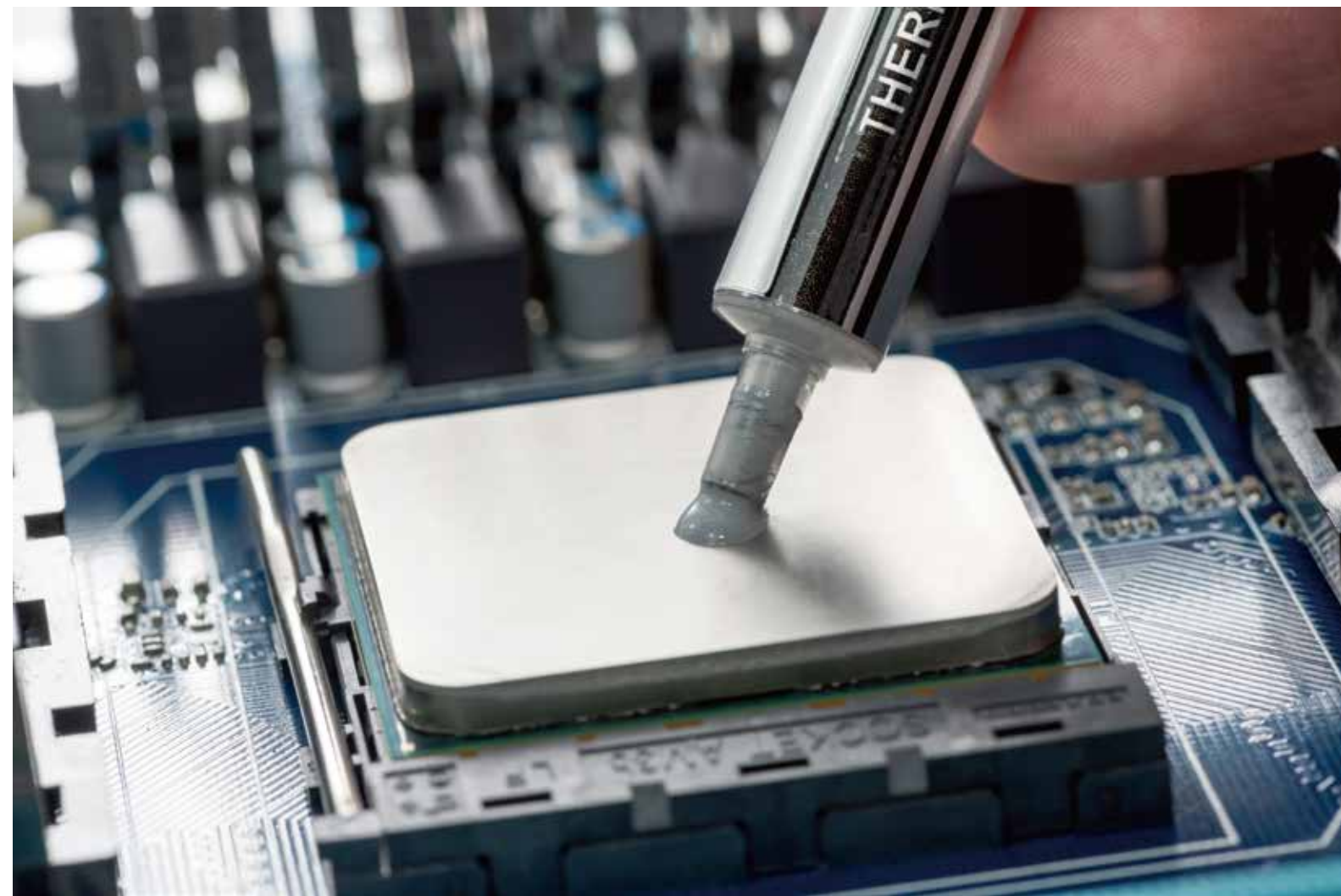


シロキサンフリー 放熱ウレタンペースト

YG/YGFシリーズ



電子部品の熱対策への課題

- シート材と放熱部材間の密着不良による排熱性能低下
- 低分子シロキサンガスによる接点障害
- 放熱ペースト塗工設備の液体移送時における機械摩耗
- ペースト材のボイド／ポンプアウトによる性能低下

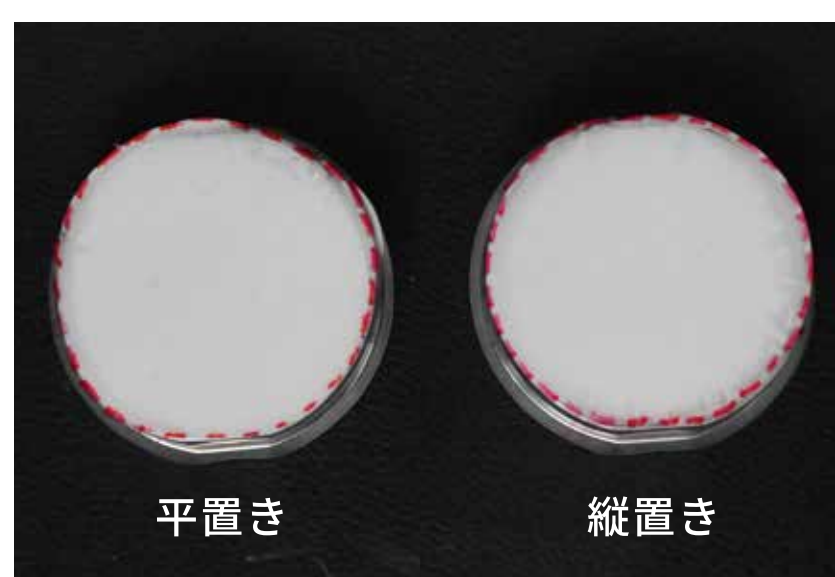
YG/YGFシリーズ特徴

01 表面処理技術



保存安定性評価 (室温／1か月後)

02 耐液だれ性



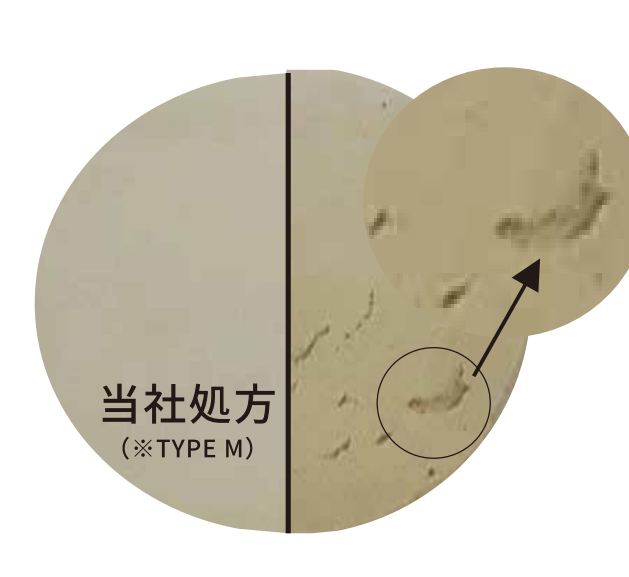
液だれ評価 (120℃／24時間)
ウレタン粘性で液だれを抑制し、
長期の排熱安定を確保

03 機械摩耗低減



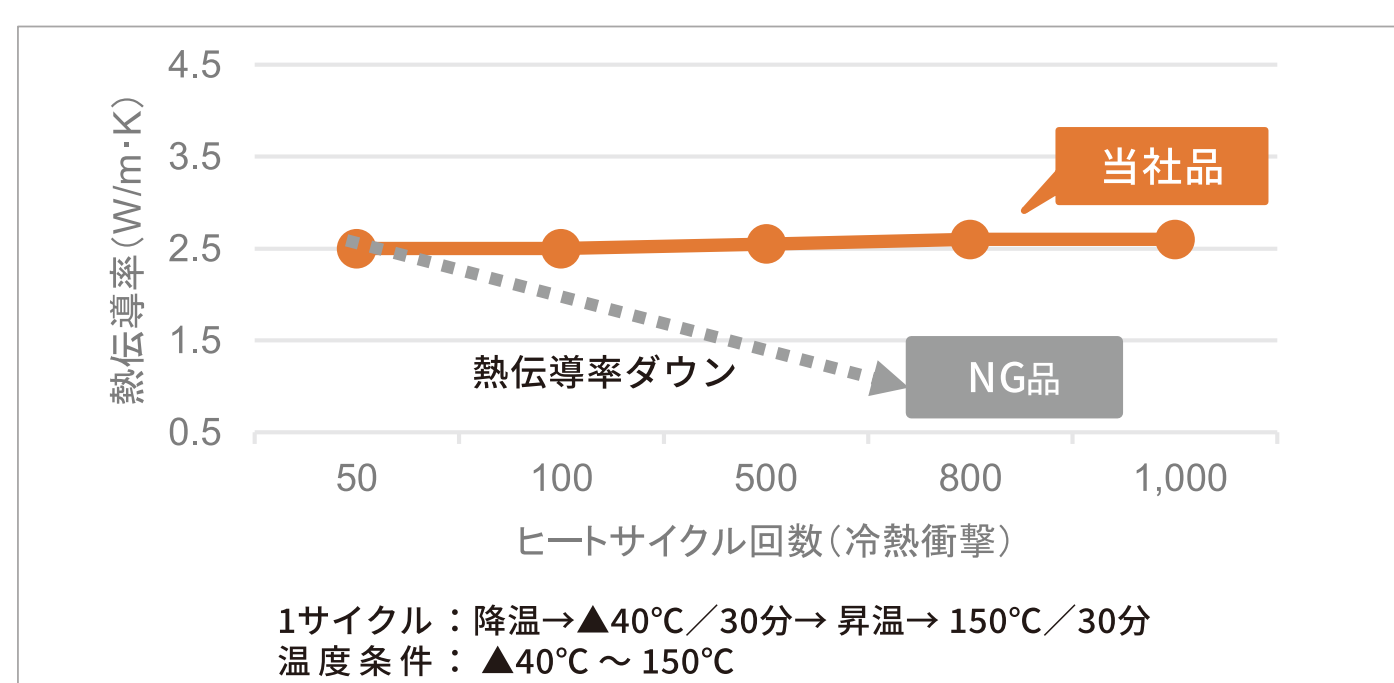
混練後コンタミ色変化評価

04 耐熱処方

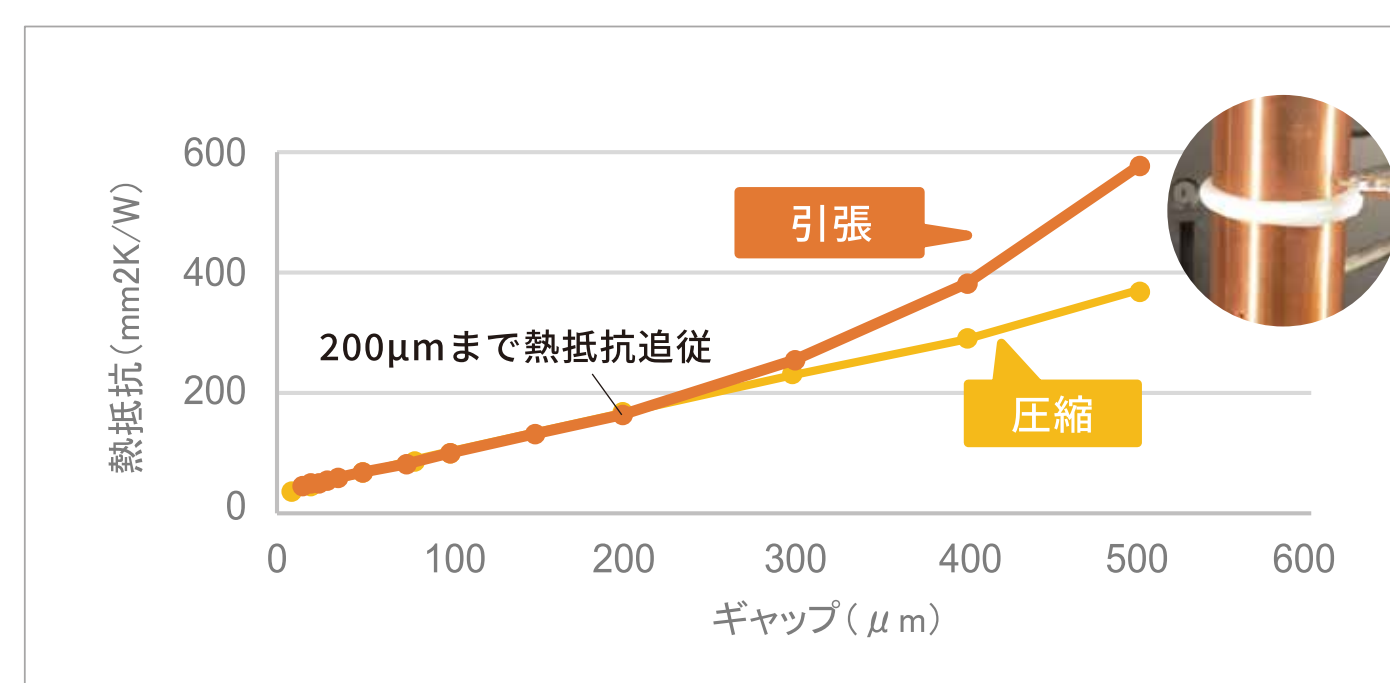


耐熱性ボイド評価 (150℃／100時間後の外観)
加熱時、熱伝導阻害要因となる
ボイドを抑制

05 長期サイクル試験



06 追従性



製品ラインナップ／提供形態

TYPE	C1	低コストグレード	1.8W/m·K
TYPE	C2	低熱伝導グレード	2.5W/m·K
TYPE	O	中熱伝導グレード	3-4W/m·K
TYPE	M	中～高熱伝導グレード	4-5W/m·K
TYPE	H	高熱伝導グレード (開発)	6W/m·K～13W/m·K

※熱伝導率測定方法：ホットディスク法



大日精化工業株式会社 / Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd.

ファインポリマー事業部 開発課

Tel: 03-3665-5645 e-mail: fp_daicolor.co.jp-bounces@daicolor.co.jp

※本物性データは、所定の試験方法における当社評価値であり、実際の適用結果を保証するものではありません。